

ICEPT 2025 大会概览

备注：最终日程以实际为准。

8 月 5 日		精致宴会厅 I, 2 楼					精致宴会厅 III, 2 楼		
	08:30-11:50	培训课程 1-2					培训课程 3-4		
	11:50-13:00	休 息							
	13:00-17:50	培训课程 5-7					培训课程 8-10		
	19:00-21:00	南北足球友谊赛							
8 月 6 日		大宴会厅, 3 楼							
	08:30-12:00	开幕式 &大会报告 1-7							
	12:00-13:30	午 餐							
	时 间	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
	13:30-15:20	专题 1	专题 2	专题 3	专题 4	专题 5	专题 6	专题 7	特别专题:
	15:20-16:00	墙报展示 A							国际混合键合
	16:00-18:30	专题 8	专题 9	专题 10	专题 11	专题 12	专题 13	专题 14	研讨会
	18:40-18:30	欢迎晚宴							
8 月 7 日	08:30-12:30	大会报告 8-13							
	12:30-13:30	午 餐							
	时 间	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
	13:30-15:20	专题 15	专题 16	专题 17	专题 18	专题 19	专题 20	专题 21	特别专题:
	15:20-16:00	墙报展示 B							ICEP 专场
	16:00-18:30	专题 22	专题 23	专题 24	专题 25	专题 26	专题 27	专题 28	EPS R10 专场

专业发展课程 8月5日 星期二, 08:30-17:50

时 间	精致宴会厅 I, 2 楼	精致宴会厅 III, 2 楼
主 席	王启东 博士 中国科学院微电子研究所	王 楠 教授 上海大学
08:30-10:00	课程-1 算力芯片的先进封装技术 于大全 博士 中国厦门云天半导体科技有限公司创始人, 厦门大学教授	课程-5 用于小芯片和异构集成的先进基板 刘汉诚 博士 中国台湾欣兴电子公司首席科学家、中国台湾工业研究院院士
10:00-10:20	休 息	休 息
10:20-11:50	课程-2 无铅焊点的性能和可靠性 Jeffrey C. Suhling 教授 美国奥本大学教授	课程-6 MEMS 封装及其先进应用 田中秀治 教授 日本东北大学教授
主 席	王 玮 教授 北京大学	殷录桥 教授 上海大学
13:00-14:30	课程-3 微电子封装断裂与分层分析 Andrew Tay 教授 新加坡国立大学客座教授	课程-7 先进封装技术的创新 葛维沪 博士 美国 Pacrim Technology 创始人
14:30-14:40	休 息	休 息
14:40-16:10	课程-4 异构集成封装与基板的 MEOL 设计与工艺考量 Gu-Sung Kim 教授 韩国江南大学教授	课程-8 量子力学与分子动力学及在电子制造中应用 刘 胜 教授 中国科学院院士、武汉大学集成电路学院院长
16:10-16:20	休 息	休 息
16:20-17:50	课程-9 纳米材料与聚合物复合材料在电子封装中的应用 吕道强 博士 德国汉高公司副总裁	课程-10 半导体封装中的高可靠性焊料 李宁成 博士 中国炫纯公司 创始人
19:00-21:00	ICEPT 2025 南北足球友谊赛	

8月6日 星期三 08:30-12:00

大会报告

主 席：张国旗 教授 荷兰工程院院士

08:30-08:45	开幕致辞： <i>叶甜春</i> 教授 大会主席 <i>张建华</i> 教授 上海大学 副校长 <i>Jeffrey C. Suhling</i> 教授 IEEE EPS 当选主席	
08:45-09:25	CP. WONG 全球电子封装奖	
09:25-09:55	老化对无铅焊料电子产品可靠性的影响	Jeffrey C. Suhling 教授 美国奥本大学先进汽车和极端环境电子中心、机械工程系教授兼系主任
09:55-10:25	芯片制造及集成多场跨尺度协同设计方法和 技术	刘 胜 教授 中国科学院院士，武汉大学集成电路学院院长
10:25-10:50	茶歇与展览交流	
主 席：田中秀治 教授 日本东北大学		
10:50-11:20	从 DIP 到 MIP:半导体封装 40 年	Kees Beenakker 教授 荷兰代尔夫特理工大学、Jiaco Instruments 公司顾问
11:20-11:50	面向硅基微显示的高密度凸点异质集成技术	张建华 教授 中国上海大学副校长
12:00-13:30	自助午餐	

8月6日 星期三, 13:30-18:30

特别专题：国际混合键合研讨会

主 席：须贺唯知 教授 日本明星大学、东京大学 教授，王启东 博士 中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心 主任

13:30-14:00	基于微泵和 Cu-Cu 混合键合的玻璃芯基板倒装芯片	刘汉诚 博士 中国台湾欣兴电子有限公司科学家、中国台湾工业研究院院士
14:00-14:30	混合键合作为未来应用的关键技术	Viorel DRAGOI 博士 奥地利 EVG 公司首席科学家
14:30-15:00	键合技术的进步推动器件结构和封装技术创新	叶五毛 博士 中国拓荆科技副总经理
15:00-15:30	面向异质异构集成的低温混合键合技术	王晨曦 博士 中国哈尔滨工业大学教授
15:30-16:00	休 息	
16:00-16:30	混合键合的界面问题探讨	李力一 博士 中国东南大学教授
16:30-17:00	推进突破键合精度与产能瓶颈	赵 滨 先生 星空科技技术总监
17:00-17:30	先进键合工艺在前道制程中的应用	任潮群 先生 芯慧联芯总经理
17:30-18:00	混合键合互连表界面调控研究	金仁喜 博士 中国科学院微电子研究所研究员
18:00-18:30	先进混合键合技术与应用	母凤文 博士 中国中科晶禾公司董事长

8 月 6 日, 13:30-18:40

专题报告

时间	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
委员会	先进封装	封装设计与建模	互连技术	封装材料与工艺	质量与可靠性	先进制造	功率电子	/

13:30-15:20	专题 A1-先进集成	专题 B1-热机械模拟与设计	专题 C1-先进互连材料与工艺	专题 D1-聚合物封装材料	专题 E1-工艺设计优化	专题 F1-键合与互连	专题 G1-功率封装设计	专题 H1-混合键合技术
主 席	王 玮, 张墅野	龙旭, 史洪宾	吴蕴雯, 汪贺	陈传彤, 曾小亮	李 逵, 代岩伟	张召富, 杨冠男	何洪文, 杨奉涛	须贺唯知, 王启东
13:30-13:55 (特邀报告)	王 戩	秦舒阳	Jonathan Abdilla	Yik-Yee TAN	路国光	张晓军	张 靖	刘汉诚 叶五毛 李力一 赵 滨 任潮群 金仁喜 母凤文
13:55-15:20 (口头报告)	8, 39, 176, 255, 331, 462, 601	47, 76, 207, 334, 369, 430, 513	213, 347, 469, 500, 603, 620, 630	63, 155, 247, 253, 341, 344, 628	7, 34, 72, 322, 476, 618	60, 199, 260, 279, 351, 502, Byeongchan Kim	154, 195, 313, 314, 376, 547, 652	
15:20-16:00	Poster Session A							
委员会	先进封装	封装设计与建模	互连技术	封装材料与工艺	质量与可靠性	光电子与显示技术	功率电子	
16:00-18:25	专题 A2-特别专题: 芯粒与板级封装	专题 B2-热管理仿真	专题 C2-3D 互连技术	专题 D2-金属封装材料	专题 E2-测试与可靠性仿真	专题 F2-光电子集成	专题 G2-功率封装材料	
主 席	马书英, 王 谦	王珺, 苏梅英	李望云, 虎良省	刘志权, 李财富	杨晓锋, 李 逵	杨连乔, 龙浩晖	侯召政, 张靖	
16:00-16:25 (特邀报告)	赵 毅 苏泳桦	钟振红	吴蕴雯	蒋 岳	Joonho You	Atsushi Okuno	梅云辉	

16:25-18:25 (口头报告)	霍 炎 孙 鹏 张康 张国平	77, 136, 202, 271, 355, 360, 452, 642	130, 131, 172, 460, 526, 617, 625	〈特邀报告: 陈 传彤〉 80, 128, 261, 294, 300, 384, 451, 475, 558, 624	32, 61, 85, 159, 315, 454, 498, 501, 517, 644	108, 113, 303, 393, 535, 543, 552, 553, 562, 572, 637	50, 59, 188, 244, 356, 362, 400, 435, 445, 489, 549	
18:40-21:00	欢迎晚宴							

8 月 7 日 星期四 08:30-12:30		
大会报告 II		
主席: 刘建影 教授 瑞典皇家工程科学院院士		
08:30-09:00	Cu-Cu 混合键合的最新进展和趋势	刘汉诚 博士 中国台湾欣兴电子公司科学家
09:00-09:30	人工智能和功率半导体的先进封装技术	菅沼 克昭 教授 日本大阪大学
09:30-10:00	制造变革时代: 半导体工艺技术驱动的晶圆级与板级封装解决方案	半那拓 博士 日本爱发科株式会社先进技术研究所 PE 半导体技术研究部总监

10:00-10:30	题目待定	陈光雄 先生 日月光半导体资深工程副总经理
10:30-10:45	茶歇与展览交流	
主 席：李世玮 教授 香港科技大学（广州）系统枢纽院长、IEEE Fellow		
10:45-11:15	前道先进封装半导体设备供应链	Kitty Pearsall 博士 美国 Boss Precision 公司总裁
11:15-11:45	异质集成、先进传感器和电子器件的低温键合技术最新发展	日暮 荣治 教授 日本东北大学
11:45-12:15	TSV 蚀刻技术应用面临的挑战与新进展	李国荣 博士 北京北方华创微电子装备有限公司
12:15-12:30	IEEE 电子封装学会在电子封装领域专业人士与学生培养中的作用	Andrew Tay 教授 IEEE EPS 项目总监
12:30-13:30	自助午餐	

8 月 7 日 星期四， 13:30-15:30

ICEP 特别专场

主 席：王俊沙，日本明星大学 主任研究员

共主席：森川 泰宏 博士 日本爱发科株式会社 经理

13:30-14:00	用于异质光子集成的表面活化室温键合技术 多喜川 良 博士, 日本九州大学副教授
14:00-14:30	聚硅氮烷介导的室温键合技术在电子封装中的应用 竹内 魁 博士, 日本东北大学助理教授
14:30-15:00	RDL 中介层的酸性镀铜工艺 山口 敦也 博士, JCU 株式会社电子发展部研发中心
15:00-15:30	磁中性环路放电等离子体在共封装光学器件低热膨胀系数玻璃基板深蚀刻中的作用 森川 泰宏 博士, 日本爱发科株式会社 经理
15:30-16:00	茶 歇

8 月 7 日 星期四, 16:00-18:30

电子与电气工程师学会封装分会 R10 互动专场

主 席：Shaw Fong WONG 博士, IEEE EPS R10 项目主席

共主席：王 谦 博士, IEEE EPS 北京分会主席

16:00-16:05	Shaw Fong WONG 博士, IEEE EPS R10 项目主席
16:05-16:25	王 谦 博士, IEEE EPS 北京分会主席
16:25-16:50	探讨功率器件银烧结环氧封装中芯片键合后环氧空洞与键合线厚度及其他因素的相关性 James Kim 先生, 马来西亚恩智浦半导体 首席工程师
16:50-17:15	先进微电子器件的热分析与失效分析 Andrew Tay 博士, 新加坡国立大学 客座教授

17:15-17:40	一种新颖的扩展工艺：基于胶带扩展、自组装与胶带冷冻分离技术的混合键合应用 Shinya Takyu 先生, 日本琳得科株式会社 助理总经理
17:40-18:05	面向计算模组的薄液膜两相沸腾散热技术 王启东 博士, 中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心主任
18:05-18:30	EPS 项目问答

8 月 7 日 星期四, 13:30-18:40								
专题报告								
时间	会场 1	会场 2	会场 3	会场 4	会场 5	会场 6	会场 7	会场 8
委员会	先进封装	封装材料与工艺	封装设计与建模	先进制造	封装设计与建模	质量与可靠性	封装材料与工艺	/
13:30-15:20	专题 A3-混合键合技术	专题 B3-陶瓷与复合材料封装材料	专题 C3-电磁仿真	专题 D3-评估与测量	专题 E3-新兴仿真技术	专题 F3-失效分析	专题 G3-封装材料	专题 H3-ICEP 特别专场
主 席	赵 凯, 刘子玉	杭 弢, 李宇杰	李 君, 魏兴昌	朱福龙, 张滋黎	杨道国, 陈 沛	侯传涛, 徐 莎	钟 毅, 范政伟	王俊沙/森川泰宏
13:30-13:55 (特邀报告)	Sarah Eunkyung Kim	Farhang Yazdani	樊海波	杨 洋	杨 程	史洪宾	Jan Vardaman	多喜川 良 竹内 魁 山口 敦也 森川 泰宏
13:55-15:20 (口头报告)	81, 245, 424, 436, 607	70, 129, 148, 152, 153, 284, 401	21, 56, 198, 210, 292, 497, 499	123, 146, 346, 359, 386, 481, 569	20, 62, 93, 134, 295, 567, 627	38, 125, 381, 391, 406, 492, 573	90, 96, 114, 137, 191, 194, 228	

15:20-16:00	Poster Session B							
委员会	先进封装&封装材料	封装材料与工艺	MEMS 封装、传感器与物联网 & 光电子	射频电子封装	新兴领域封装&封装材料	质量与可靠性	质量与可靠性 & 互连技术	/
16:00-18:25	专题 A4-热管理与接口	专题 B4-工艺材料与可靠性	专题 C4: MEMS 封装、传感器与物联网	专题 D4-射频滤波器与电子封装	专题 E4-新兴封装技术	专题 F4-可靠性测试与建模	专题 G4-可靠性设计	专题 H4-R10 互动专场
主席	张 弛, 马盛林	马浩然, 张 亮	徐高卫, 尚金堂	王 楠, 孙 跃	田艳红, 于大全	徐 莎, 侯传涛	范政伟, 钟 毅	Shaw Fong WONG/王谦
16:00-16:25 (特邀报告)	鲍 华	李望云	Daiki Nakaya	TBD	Eu Poh Leng	Karsten Meier	吴政达	王 谦 James Kim Andrew Tay Shinya Takyu 王启东
16:25-18:40 (口头报告)	229, 485, 488, 536, 537, 578, 539, 541, 544, 626	22, 31, 52, 227, 352, 404, 440, 505, 515, 540	98, 192, 216, 220, 368, 428, 453, 580	327, 466, 554, 555, 570, 611, 613, 634, 636	<特邀: 窦广彬> 221, 258, 342, 378, 397, 418, 297, 390 439	9, 15, 42, 46, 95, 288, 389, 409, 410, 448	55, 306, 414, 512, 621, 144, 217, 345, 551, 619	



温馨提示

尊敬的各位嘉宾：

诚挚欢迎您参加第 26 届电子封装技术国际会议（The 26th International Conference on Electronic Packaging Technology, ICEPT 2025）。本届会议将于 2025 年 8 月 5-7 日在上海嘉定区隆重举行。

过去 26 年，ICEPT 已发展成为电子封装领域最具影响力和最高水平的学术与产业盛会之一。会议始终致力于促进电子封装材料、工艺、设备、设计、可靠性等多学科的交流与合作，搭建起学术界与产业界互动、创新、共赢的国际化平台。本届会议将继续秉承“创新发展、交流合作”的宗旨，邀请全球知名专家学者和企业界精英，共同探讨电子封装技术最新进展、未来趋势及产业应用。

本届会议内容丰富，亮点纷呈，包括：

- 大会主旨报告和前沿分论坛，分享全球最新研究热点与产业动态；
- 学术论文和成果展示，展示前沿科研创新和技术突破；
- 产学研专题研讨，促进跨领域深度对接、资源共享与协同创新；
- 全球电子封装奖与大会优秀论文评选，激发新生力量，推动人才成长。



➤ 客房住宿预定方式

① 预定链接

<https://www.marriott.com.cn/event-reservations/reservation-link.mi?id=1742288888619&key=GRP&app=resvlink>

② 扫描下方二维码预定



*注意事项：酒店预定截止日期为 **2025 年 8 月 1 日**

➤ 交通提示

酒店附近交通：



上大。学校在中国革命史和教育史上留下了光辉的一页，彼时享有“文有上大，武有黄埔”“北有五四时期的北大，南有五卅时期的上大”的盛誉。

20 世纪 20 年代的上海大学践行“养成建国人才，促进文化事业”的办学宗旨，成就瞩目，英才济济。学校以列入上海高水平地方大学建设为契机，践行新时代新发展理念，抢抓机遇、锐意改革，追卓越、创一流，努力在世界大学行列中书写鲜明印记，在践行上海城市品格中彰显上大特质。学校入选国家“双一流”建设高校，综合实力持续提升，软科世界大学学术排名连续四年位列全球前 300，上海高校分类评价连续三年位列上海学术研究型高校第 5，全面开启建设中国特色、世界一流的综合性研究型大学新征程。

未来半导体

未来半导体，是集媒体、会务和资源库于一体的半导体资讯交流平台。以“洞察天下‘芯’事，赋能产业发展”为己任，平台聚焦六大业务板块：内容媒体、会务会展、杂志期刊、活动策划、调研咨询、项目对接。平台关联企业已累计举办了近 100 场半导体行业研讨会、会展、技术讲座、产品推介会、培训及媒体发布会，内容涉及芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备、半导体材料、机器人、半导体投融资等多个行业。联合出品中国半导体封装测试产业调研报告等多个报告，累计服务半导体企业超 10000 家。